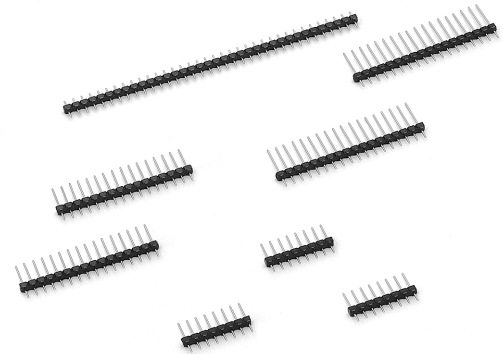
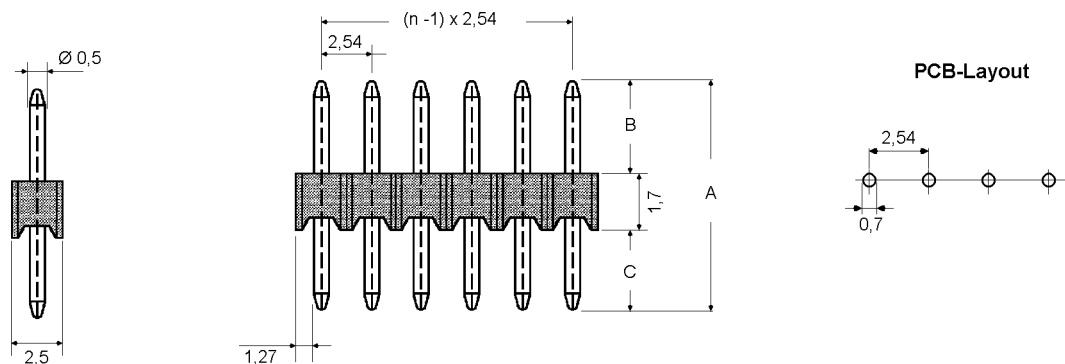


**Technische Daten / Technical Data:**

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Rundstift Ø 0,50 mm, CuZn 30
Contact Material	Round Pin Ø 0,50 mm, CuZn 30
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3-2,5 µm)
Contact Surface	acc. to options (see below), over Ni (1,3-2,5 µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Contact Resistance	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>9</sup> Ohm
Insulation Resistance	> 10 <sup>9</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit	1000 V <sub>DC</sub>
Test Voltage	1000 V <sub>DC</sub>
Nennspannung	250 V <sub>AC</sub>
Current Voltage	250 V <sub>AC</sub>
Nennstrom	2 A
Current Rating	2 A
Temperaturbereich	-55°C...+125°C
Temperature Range	-55°C...+125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-Soldering, further informations in chapter T



Passende Gegenstecker Serie:  
Mates with Connector Series:  
182 / 186



n = Anzahl der Kontakte  
n = No. of Contacts

Series	Dimensions*	Contacts*	Plating*
152	08	040	10
	08 = A/B/C : 6,50 / 2,30 / 2,50 09 = A/B/C : 8,30 / 3,30 / 3,30 12 = A/B/C : 11,30 / 6,30 / 3,30 13 = A/B/C : 12,60 / 7,60 / 3,30 15 = A/B/C : 14,70 / 9,70 / 3,30	001-040-pol. einreihig single row	00 = vergoldet gold plated 10 = 0,25 µm Gold 0,25 µm gold plated

Auf Wunsch werden die Stiftheisten in jeder gewünschten Polzahl gefertigt.  
Raster 5,08 / 7,62 ... oder Sonderraster auf Anfrage.  
Any number of contacts can be produced.  
Pitch 5,08 / 7,62 ... or other pitch on request.

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications. )

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

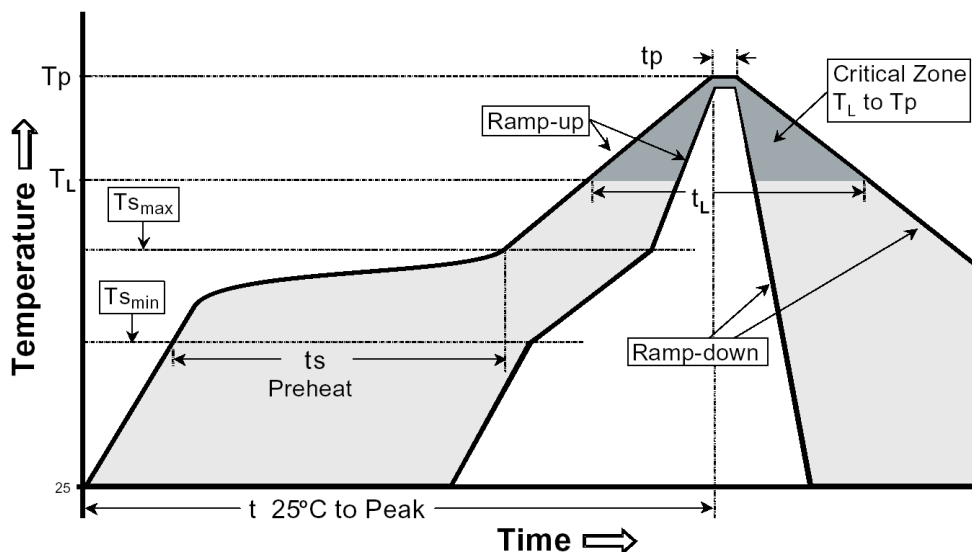
© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T